

## Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

**Beliehene gemäß § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV**  
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen  
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

# Akkreditierung



Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestätigt hiermit, dass das Prüflaboratorium

**encontec GmbH**

**Marie-Curie-Straße 19, 73529 Schwäbisch Gmünd**

am Standort:

**Leobener Straße 104, 70469 Stuttgart**

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 besitzt, Prüfungen in folgenden Bereichen durchzuführen:

**Härteprüfung nach Vickers an metallischen Werkstoffen;**  
**visuelle Prüfung und Vermessung von elektronischen Erzeugnissen mit der Mikroskopie,**  
**2-dimensionale Vermessung von Rissen in Schlibbildern mit der Mikroskopie**

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 27.06.2022 mit der Akkreditierungsnummer D-PL-20100-01. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 2 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: **D-PL-20100-01-00**

Berlin, 27.06.2022

Im Auftrag Dr. Tobias Poeste  
Fachbereichsleitung

*Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zu entnehmen. <https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen>*

# Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

## Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-20100-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

**Gültig ab:** 27.06.2022

Ausstellungsdatum: 27.06.2022

Urkundeninhaber:

**encontec GmbH**  
**Marie-Curie-Straße 19, 73529 Schwäbisch Gmünd**

am Standort:

**Leobener Straße 104, 70469 Stuttgart**

Prüfungen in den Bereichen:

**Härteprüfung nach Vickers an metallischen Werkstoffen;**  
**visuelle Prüfung und Vermessung von elektronischen Erzeugnissen mit der Mikroskopie,**  
**2-dimensionale Vermessung von Rissen in Schlifffbildern mit der Mikroskopie**

**Innerhalb der mit \* gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.**

*Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.*

*Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zu entnehmen. <https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen>*

**1 Härteprüfung nach Vickers an metallischen Werkstoffen \***

DIN EN ISO 6507-1                      Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Vickers - Teil 1:  
2018-07                                      Prüfverfahren

**2 Visuelle Prüfung und Vermessung von elektronischen Erzeugnissen mit der Mikroskopie**

IPC A-610                                      Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen  
Revision F                                      (hier: *Kapitel 4, 5, 7, 8, 9, 10*)  
2014-07

PV 01 V2.00                                      2-dimensionale Vermessung von Rissen in Schliffbildern mittels  
2022-03                                      Mikroskopie

PV 02 V2.00                                      Visuelle Begutachtung von elektronischen Erzeugnissen mittels  
2022-03                                      Stereomikroskopie

**Verwendete Abkürzungen:**

DIN	Deutsches Institut für Normung e. V.
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organization for Standardization
IPC	Normative Dokumente der Association Connecting Electronics Industries
PV	Hausverfahren der encotec GmbH